

| 刊期 | 封面故事 | 趨勢與分析 | | | | 設計與技術 | |
|--|----------------|-------|-------|------|------|-----------------------------------|----------|
| | | 業界趨勢 | 思維與觀點 | 精英訪談 | 創新天地 | 設計新技術 | 測試與測量 |
| 1月刊 廣告預訂截止日期: 2022年11月23日 材料提交截止日期: 2022年11月28日 | 新年展望 | • | • | • | • | - 混合訊號電路設計 - 資料安全與加密 - MCU | 微波射頻測試 |
| 2月刊* 廣告預訂截止日期: 2022年12月23日 材料提交截止日期: 2022年12月28日 | 新能源 / 碳中和 | • | • | • | • | - 智慧電網 - 無線通訊 - 類比電路設計 | 示波器 |
| 3月刊 廣告預訂截止日期: 2023年1月19日 材料提交截止日期: 2023年1月20日 | EDA 點工具 / 全流程 | • | • | • | • | - LED 照明 - 光電及顯示 - MEMS 感測器 | EMI 測試 |
| 4月刊 廣告預訂截止日期: 2023年2月23日 材料提交截止日期: 2023年2月28日 | 面板驅動 IC/ 電源晶片 | • | • | • | • | - 馬達控制 - RF/ 微波 - 伺服控制 | 網路分析儀 |
| 5月刊 廣告預訂截止日期: 2023年3月23日 材料提交截止日期: 2023年3月28日 | 射頻 / 無線通訊 | • | • | • | • | - 穿戴式裝置設計 - 能量採集 - 數位訊號處理 | 測試軟體 /IP |
| 6月刊 廣告預訂截止日期: 2023年4月24日 材料提交截止日期: 2023年4月28日 | 車規級晶片 /MCU | • | • | • | • | - 醫療電子 - ADC/DAC - 邊緣運算 | 訊號完整性測量 |
| 7月刊* 廣告預訂截止日期: 2023年5月23日 材料提交截止日期: 2023年5月29日 | Chiplet/3D IC | • | • | • | • | - 音訊設計 - FPGA/DSP - 晶圓代工 | 阻抗測量 |
| 8月刊 廣告預訂截止日期: 2023年6月21日 材料提交截止日期: 2023年6月28日 | RISC-V | • | • | • | • | - EMI/EMC - 電路保護 - 雷達技術 | 嵌入式系統測試 |
| 9月刊 廣告預訂截止日期: 2023年7月24日 材料提交截止日期: 2023年7月28日 | 類比 IC 和 IDM 策略 | • | • | • | • | - 人機互動 - 觸控技術 - 語音辨識 / 處理 | 混合訊號測量 |
| 10月刊 廣告預訂截止日期: 2023年8月23日 材料提交截止日期: 2023年8月28日 | 手機衛星通訊 | • | • | • | • | - 功率元件 - 低功耗設計 - 數位電源 | 向量訊號分析 |
| 11月刊 廣告預訂截止日期: 2023年9月22日 材料提交截止日期: 2023年9月28日 | 機器視覺 /AI | • | • | • | • | - 5G 通訊 - 無線連接 - 視訊監控 | 頻譜分析儀 |
| 12月刊* 廣告預訂截止日期: 2023年10月23日 材料提交截止日期: 2023年10月27日 | 資料中心大晶片 /DPU | • | • | • | • | - PCB 設計 - 高頻設計 - 嵌入式設計 | 電源完整性測量 |

* Digital only

編輯查詢:

有關台灣版的編輯及其他相關事項查詢, 請與 Anthea Chuang (Anthea.Chuang@aspencore.com) 聯繫。

有關中國大陸版的編輯及其他相關事項查詢, 請與 Luffy.liu (Luffy.liu@aspencore.com) 聯繫。

注: 發行人保留對以上文章刪除及改動的權利。